

Presseinformation

Versiert, verlässlich, vielseitig – Viscom auf der SMTconnect 2019

Hannover, April 2019 – SMTconnect, Stand-Nr. 4A - 120 – 35 Jahre Erfahrung in der Baugruppeninspektion schlagen sich bei der Viscom AG nicht nur in der erstklassigen Prüfqualität und überragenden Geschwindigkeit der angebotenen Inspektionssysteme nieder, sondern auch in deren vielfältigen Anwendungsfeldern. Auf der Elektronikfachmesse SMTconnect vom 7. bis 9. Mai 2019 in Nürnberg wird live die volle Bandbreite der Inspektionstechnologien von Viscom zu sehen sein – von der Lotpastenprüfung über die SMD- und Lötstelleninspektion bis hin zur sicheren Erkennung von Voids, der Inspektion von Drahtverbindungen und der Kontrolle von Lackschichten. Unter dem Motto „Die Zukunft der Elektronikfertigung“ zeigt Viscom modernste Industrie-4.0-Lösungen und zeitgemäße intuitive Tools der Inspektionssoftware vVision.

Beim Lotpasteninspektionssystem **S3088 SPI** von Viscom überzeugen insbesondere die Möglichkeiten einer intelligenten Verknüpfung der Ergebnisse mit der Lötstellen- und Bestückungskontrolle (3D-AOI) sowie dem Pastendrucker und Bestückungsautomat. Im Hintergrund verantwortlich ist die Viscom-Software **Quality Uplink**. Ergebnisse aller Prüftore lassen sich für Gesamtbeurteilungen einzelner Bauteile oder Lötstellen heranziehen sowie automatisch Aktionen anderer Maschinen anstoßen, etwa eine notwendige Versatzkorrektur. „Besucherinnen und Besucher der SMTconnect können sich von der S3088 SPI nicht nur bei uns, sondern zusammen mit unserem 3D-AOI-System S3088 *ultra chrome* auch in einer Fertigungsline am Stand von Panasonic Industry Europe überzeugen“, informiert Carsten Salewski, Vorstand Vertrieb, Marketing und internationales Geschäft der Viscom AG.

Am Messestand von Viscom wiederum sind sechs weitere Inspektionssysteme zu sehen: Weltweit bei namhaften Elektronikfertigern für höchste Produktqualität sorgt heute mit bester 3D-AOI-Sensorik die

S3088 ultra gold. Das bewährte, flexible System liefert schnell und zuverlässig erstklassige Mess- und Inspektionsergebnisse sowie sehr realitätsgestreue Rundumsichten (360View) als zusätzliche Hilfe für Fehlerbeurteilungen im Rahmen der Verifikation. Als Neuentwicklung im Bereich High-End-3D-AOI präsentiert Viscom die **S3088 DT**: Konzipiert für Anforderungen der Großserienfertigung punktet das neue Inline-System mit hochpräziser Prüfqualität und rasantem Doppelspurbetrieb. Sein integrierter Monitor ermöglicht eine besonders platzsparende Aufstellung in der Fertigungsline.

Die Vorteile des Verifikationsplatzes vVerify von Viscom kann man sich während der Messe ebenfalls live zeigen lassen. Hier werden zur Beurteilung eines möglichen Produktionsfehlers auch Röntgenbilder von Viscom-Inspektionssystemen herangezogen. Das bereits fünffach international ausgezeichnete 3D-AXI-System **X7056-II** kann mit Hilfe der planaren Computertomografie orthogonale und vertikale Schichten aus Volumeninformationen generieren und so sehr zielgenau z. B. Voids in Lötstellen aufdecken. Für den automatischen Wechsel der zu prüfenden Baugruppen braucht dieses leistungsstarke 3D-AXI-System im Idealfall gerade mal vier Sekunden.

Für die manuelle Röntgenprüfung von Prototypen oder zwecks Stichproben setzen Elektronikfertiger auf 3D-MXI-Systeme von Viscom. Die **X8011-II PCB** zeichnet sich durch eine brillante Röntgenbildqualität aus und umfangreiche Software-Features machen es zu einem sehr verlässlichen Prüftor für die Kleinserieninspektion. Für ein flexibles Probenhandling in dem System bietet Viscom mehrere verschiedene Spezialmodule an, darunter eine motorische Dreh- und Kippachse sowie ein Rotationsmodul. „Alle Details kann man sich auf der SMTconnect ausführlich direkt an der Maschine erklären lassen. Darüber hinaus stehen wir auch zur Verfügung, wenn es um die Umsetzung sehr spezieller kundenspezifischer Projekte geht“, so Rolf Demitz, Bereichsleiter für neue Produkte und Sonder-Inspektionssysteme bei Viscom.

Die ebenfalls ausgestellten Systeme **S6056BO** für durchsatzstarke Bondinspektion und **S3088 CCI** für eine genaue Prüfung von Lackschichten auf Leiterplatten unterstreichen zusätzlich das breite kundenspezifische Angebot. Die Vielfalt der Lösungen und die Entwicklungskompetenz machen Viscom zu einem verlässlichen Experten, der mit seinen Innovationen auch in Zukunft neue wegweisende Maßstäbe setzen wird.

Bildunterschrift: Am Messestand von Viscom auf der SMTconnect zu sehen sind die Systeme S3088 *ultra gold*, S3088 DT, X7056-II, X8011-II PCB, S3088 CCI, S6056BO und S3088 SPI

Über Viscom

Die Viscom AG entwickelt, fertigt und vertreibt hochwertige Inspektionssysteme. Das Spektrum umfasst die komplette Bandbreite der optischen Inspektion und Röntgenprüfung. Im Bereich der Baugruppeninspektion für die Elektronikfertigung gehört das Unternehmen zu den führenden Anbietern weltweit. Die Systeme von Viscom lassen sich kundenspezifisch konfigurieren und miteinander vernetzen. Hauptsitz und Fertigungsstandort des Unternehmens ist Hannover. Viscom verfügt über ein großes internationales Netz aus Niederlassungen, Applikationszentren, Servicestützpunkten und Repräsentanten. Gegründet 1984 notiert Viscom seit 2006 an der Frankfurter Wertpapierbörsen (ISIN: DE0007846867). Weitere Informationen: www.viscom.de.